

PCN # 20150209000
DP83848 ファミリー製品 TI-Taiwan 組立サイト追加認定(with new BOM)

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20150209000	PCN 日付:	2/10/2015																				
表題:	DP83848 ファミリー製品 TI-Taiwan 組立サイト追加認定(with new BOM)																						
PCN 詳細																							
変更内容:																							
TI は、DP83848 製品ファミリーについて、追加組立サイトとして TI-Taiwan サイトの認定を連絡します。部材(BOM)の相違は下記の通りです。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TI Melaka</th> <th>ASEK</th> <th>TAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>8001746</td> <td>SID#1400013111</td> <td>4211470</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>8095183</td> <td>SID#1800008161</td> <td>4209640</td> </tr> <tr> <td>Bond Wire Composition / Diameter</td> <td>Au, 1.0 mils</td> <td>Au, 1.0 mils</td> <td>Cu, 0.8 mils</td> </tr> <tr> <td>Lead Finish</td> <td>Matte Sn</td> <td>Matte Sn</td> <td>NiPdAu</td> </tr> </tbody> </table> 本 PCN 変更実施以降、TI は、対象製品の鉛フリー対応製品を、単一の標準製品名 (single standard part number) に統合します。例えば、DP83848CVV/NOPB の製品名で Matte Sn もしくは NiPdAu/Ag 表面処理の製品が出荷されることになります。 例: —お客様が DP83848CVV/NOPB 製品 7500 個(標準梱包数量(SPQ): 2500 個/リール)を発注します。 —TI は、上記発注に対して下記の何れかの出荷形態で対応します。 I. NiPdAu 端子表面処理製品 3 リール II. Matte Sn 端子表面処理製品 3 リール III. Matte Sn 端子表面処理製品 2 リール+NiPdAu 端子表面処理製品 1 リール IV. NiPdAu 端子表面処理製品 2 リール+Matte Sn 端子表面処理製品 1 リール					TI Melaka	ASEK	TAI	Mount Compound	8001746	SID#1400013111	4211470	Mold Compound	8095183	SID#1800008161	4209640	Bond Wire Composition / Diameter	Au, 1.0 mils	Au, 1.0 mils	Cu, 0.8 mils	Lead Finish	Matte Sn	Matte Sn	NiPdAu
	TI Melaka	ASEK	TAI																				
Mount Compound	8001746	SID#1400013111	4211470																				
Mold Compound	8095183	SID#1800008161	4209640																				
Bond Wire Composition / Diameter	Au, 1.0 mils	Au, 1.0 mils	Cu, 0.8 mils																				
Lead Finish	Matte Sn	Matte Sn	NiPdAu																				
変更理由:																							
供給確保																							
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:																							
なし																							

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等